

# JEITA LPB-SC LPB Forum2022TG

## 活動報告

半導体&システム開発技術SC  
SSD-SC



# フォーラム2022TG

・LPBフォーラム2022TG立ち上げ

リーダー: 村岡さん

日時: 2023年3月3日(金)13:30~

場所: Hybrid(JEITA+Web)

内容: 次回(11/11)以降で決める

まずはそれまでにスケジュールを検討いただく

**会議室は以下で予約済**

会議室名: 大手町ファーストスクエアカンファレンス

部屋番号: Room D(スクール形式72名/2名掛)

予約時間: 10:00-18:00(8h)

室料 : ¥109,900 (税別)

有料備品: インターネット単独回線¥10,000

無線ルーター(同時接続目安 50台)¥5,000

プロジェクター/カメラ/配信用マイクはJEITAより借用

無料備品: ワイヤレスマイク 4本/演台/両面ホワイトボード 2台/120インチスクリーン/CD/MDプレイヤー

→11/22のSSD-SCにて費用承認された。(合計 124,900円)

下見 : 要予約 1/27のSSD-SCの際に行う?

発表者の顔を映す? 配信用のマイクの扱いはどうする?(現地とWEBの両立は?) ビデオカメラはJEITA借用?

# フォーラム活動スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
SSD-SC		▲(5/27)		▲(7/22)		▲(9/16)		▲(11/22pr25)		▲(1/27)		▲(3/14)
LPB/SDF WG			▲(6/24)		▲(9/9)		▲(10/21)		▲(1/6)			▲(3/14)
ライブラリTG		▲(6/17)	▲(7/29)	▲(8/8)		▲(10/7)	▲(11/11)	▲(12/9)		▲(2/3)		(4/7) ▲
イベント					▲(9/9) LPB ワークショップ 2022					▲(1/31) JEVeC LPB		▲(3/3) LPBフォーラム 2022
■ イベント 実施方法検討												
プログラム内容検討												
資料準備												
資料事前公開					▲(9/7 13:00-)							▲(3/1)
リハーサル? 実施方法決定					▲(9/x)							▲(3/x)
Webページ作成・管理												
申込ページ作成												
アンケート内容検討												
アンケート準備												
■ 広報												

12/9



# フォーラム2022TG

## ・LPBフォーラム2022TG

リーダー：村岡さん

日時：2023年3月3日(金)13:30～

場所：Hybrid(大手町ファーストスクエアカンファレンス+Web)

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-5-1 ファーストスクエア イーストタワー2F

## プログラム内容：

プログラム(案)	発表者	時間	タイムスケジュール
1. 開催にあたって	福場さん	10分	13:30-13:40
2. 電子デバイスモデル仕様書標準化の必要性調査報告の概要紹介	増山様	30分	13:40-14:10
3. MBSE/MBDによる設計フロー構築とLPBフォーマットの活用	福場さん、村田さん、古賀さん	30分	14:10-14:40
4. 休憩		10分	14:40-14:50
5. フロントローディングの領域拡張 『EMCフロントローディング設計 いろいろ』(仮)	林さんチーム	120分	14:50-16:50
6. 閉会の挨拶・連絡事項	司会	10分	16:50-17:00

# LPBフォーラム2022振り返り

キーワード	コメント
Webex events	<ul style="list-style-type: none"><li>・今回は大手町ファーストスクエアカンファレンス+リモートで開催。</li><li>・質疑応答で会場は問題無かったが、おそらくリモート参加の方は聞き取れない人が居たと思う。どうやって両立するかは今後の課題。</li><li>・両立する方法は無いかも。リアル参加を優先するというのも一つの考え方。今回は約半数がリアル参加だった。</li><li>・画面が固まったり、音声途切れたりといった声は無かった。</li><li>・</li></ul>
アンケート	<ul style="list-style-type: none"><li>・今回もJEITAのシステムを利用。作成の手間が無いのは良い。</li><li>・自由表記の結果が表示されない。</li><li>・今回の回答率は59%と過去最高。スマホのアクセスが増えているのが原因か？</li><li>・今のところ社内環境からアクセスできなかったという声は無かった。</li><li>・アンケートシステムに違和感は無かった。使いやすい</li><li>・JEITAは回答者については、教えてくれない。</li><li>・</li></ul>
会場	<ul style="list-style-type: none"><li>・今回はJEITAの会議室が取れなかったため、外部の会議室を使ったので例年と比べると追記の費用が掛かった。</li><li>・来年度以降はJEITAの会議室も費用が発生するので、外部の安いところを探した方が良くも。</li></ul>

# LPBフォーラム振り返り

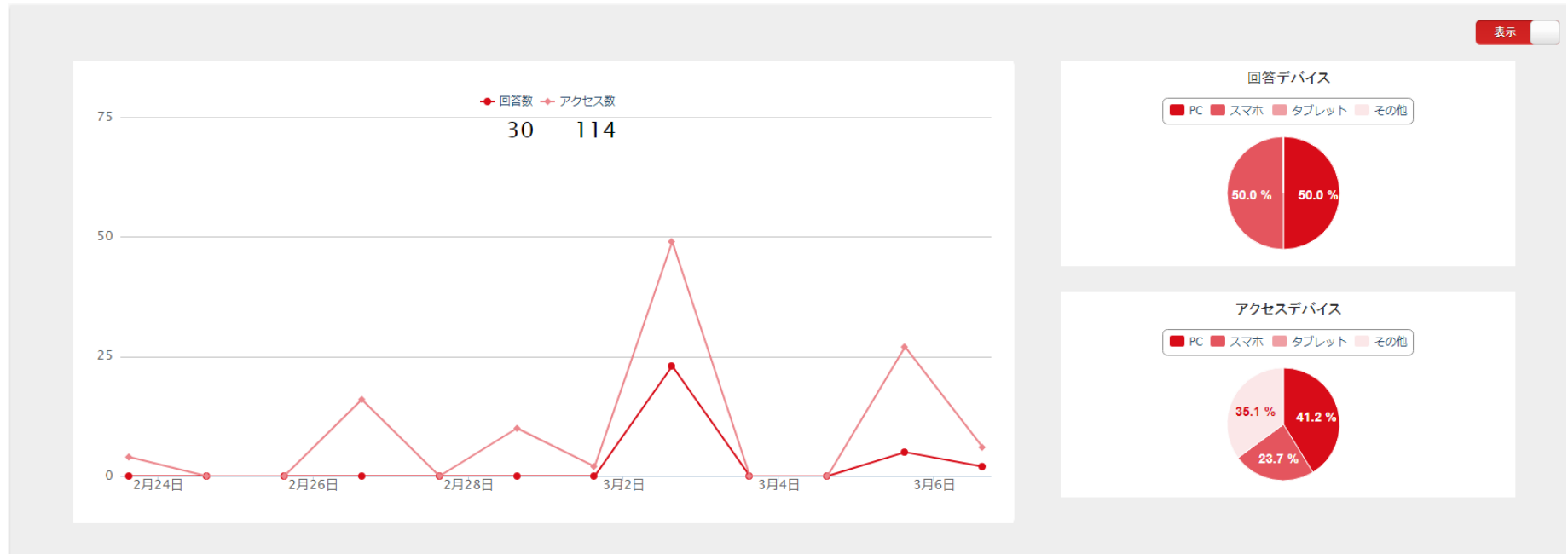
キーワード	コメント
リハーサル	<ul style="list-style-type: none"><li>・当日のフォーラム前に実施。ブレイクアウトセッション等使わなかったため、当日のリハーサルのみでも特に問題無かった。</li><li>・</li></ul>
当日の配信について	<ul style="list-style-type: none"><li>・大きなトラブルなく配信出来た。</li><li>・リアル開催メインで進めた事もあって、運営はうまくいったと思う。</li><li>・</li></ul>
発表者	<ul style="list-style-type: none"><li>・今回はリアル参加メインで進め、プレゼン資料もWEB共有したものをスクリーンに映したので特に大きな問題は無かった。</li><li>・やはり顔が見える状態の方が進行もし易い。</li><li>・</li></ul>
公開資料のURL	<ul style="list-style-type: none"><li>・前回同様に今回も事前に資料を公開しなかった。</li><li>・資料公開のタイミングがまちまちなので、HPに間に合わない分は「残りは準備中」と記載。</li><li>・お礼メールには資料の掲載状況を明記 &amp; 「全掲載後にメルマガでお知らせ」と記載。</li><li>・上記の対応で、公開資料については特に問合せ等は無かった。</li><li>・</li></ul>

# アンケート実施方法・回答数

- ・今回は前回同様にJEITAのアンケートシステムを使用。
- ・今回の回答率は、59%で過去最高。
- ・参加者は51名と前回よりも増加している。
- ・前回に続いてリアル＋リモートのハイブリッドで開催したが、今回は大手町ファーストスクエアカンファレンスを使用。22名のリアル参加があった。

	回答数	参加者	回答率
第12回LPB Forum	28名	73名	38%
第13回LPB Forum	36名	69名	52%
LPBワークショップ2022	18名	43名	42%
LPBフォーラム2022	30名	51名	59%

# アンケート内容



前回と比較すると「スマホ」がアクセス(7%→24%)、回答(6%→50%)共に大幅に増加している。

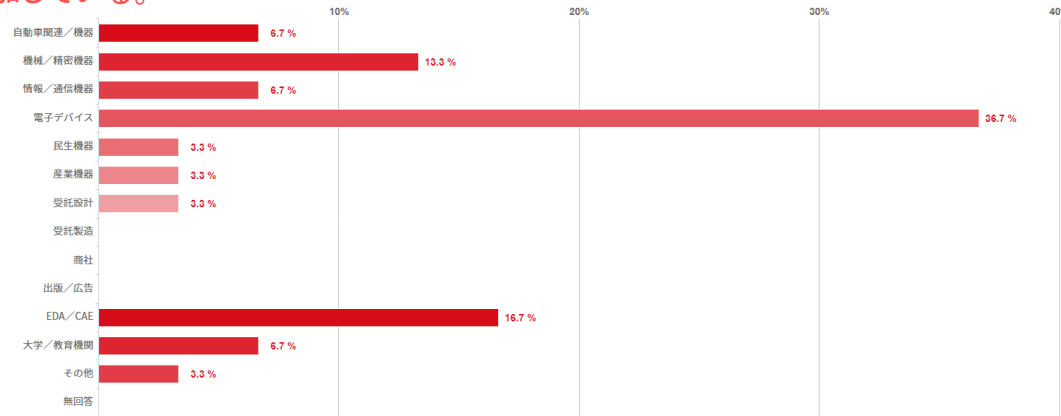


# アンケート内容

## Q2.

あなたの業種について(1つお選びください)  
(回答数: 30)

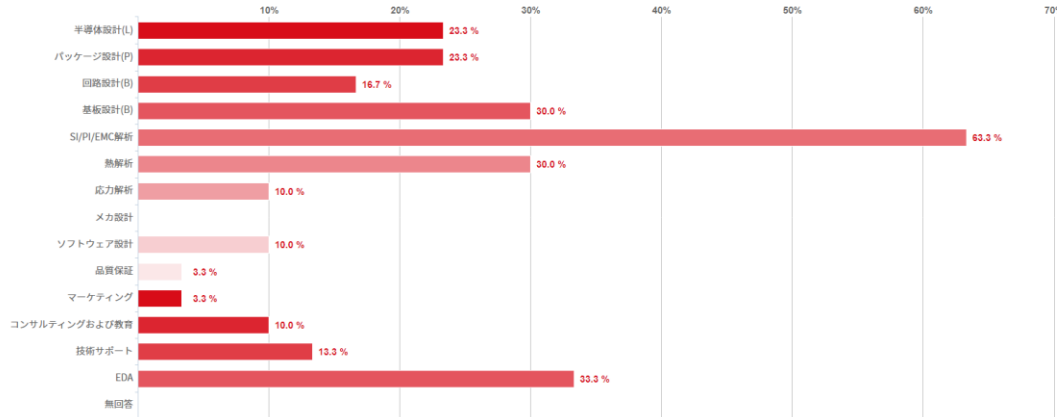
従来同様に「電子デバイス」・「EDA/CAE」が多いが、前回0%だった「自動車関連」、「情報/通信」の方が7%ほど参加している。



## Q3.

あなたの職種について(該当するものをすべてお選びください)  
(回答数: 30)

従来通り「SI/PI/EMC解析」の割合が高い。前回と比較すると「回路設計」の割合が6%→17%に増加している。

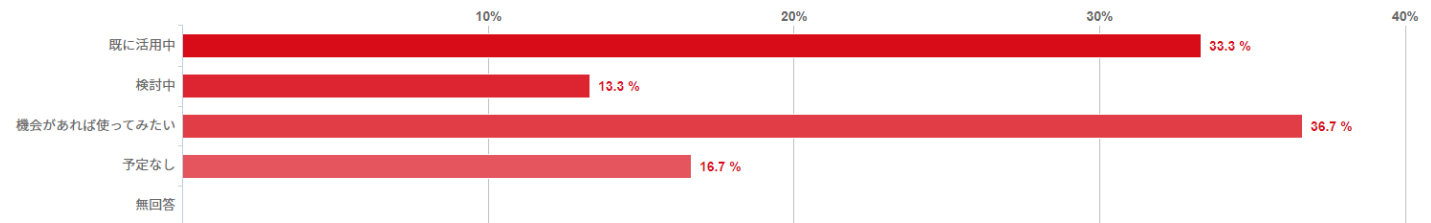


# アンケート内容

## Q4.

あなたのLPBフォーマット活用状況について(1つお選びください)  
(回答数: 30)

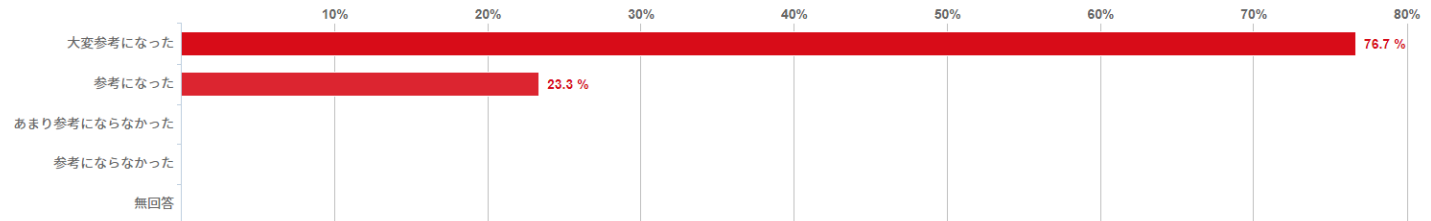
前回と比較すると「既に活用中」が28%→33%へ、「機会があれば使ってみたい」も22%→37%に増加。



## Q5.

本フォーラム全般について(1つお選びください)  
(回答数: 30)

前回と比較すると「大変参考になった」との意見が56%→77%に増加。



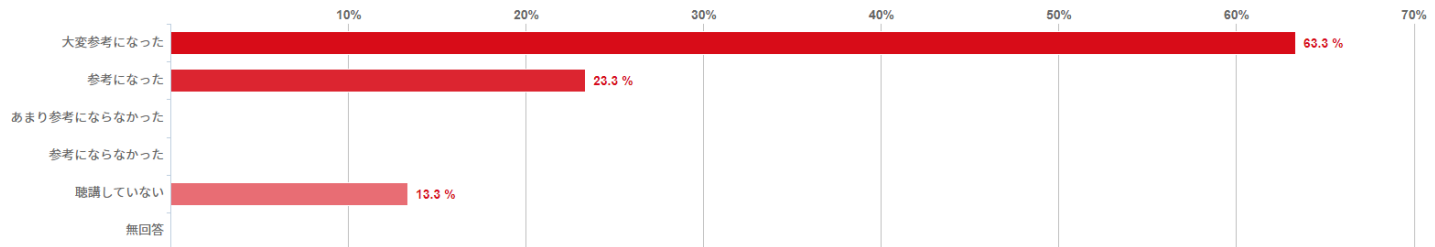
# アンケート内容

## Q6.

電子デバイスモデル仕様書標準化の必要性調査報告の概要紹介について(1つお選びください)

(回答数: 30)

参考になったとの意見が多い。

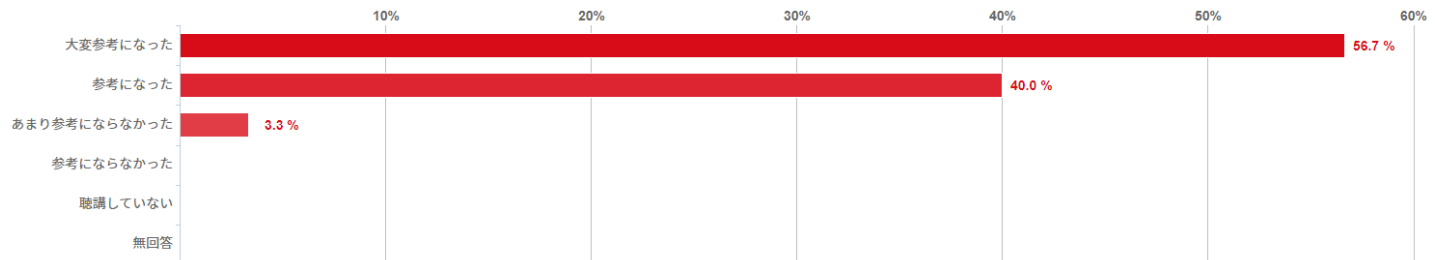


## Q7.

MBSE/MBDによる設計フロー構築とLPBフォーマットの活用について(1つお選びください)

(回答数: 30)

参考になったとの意見が多い。



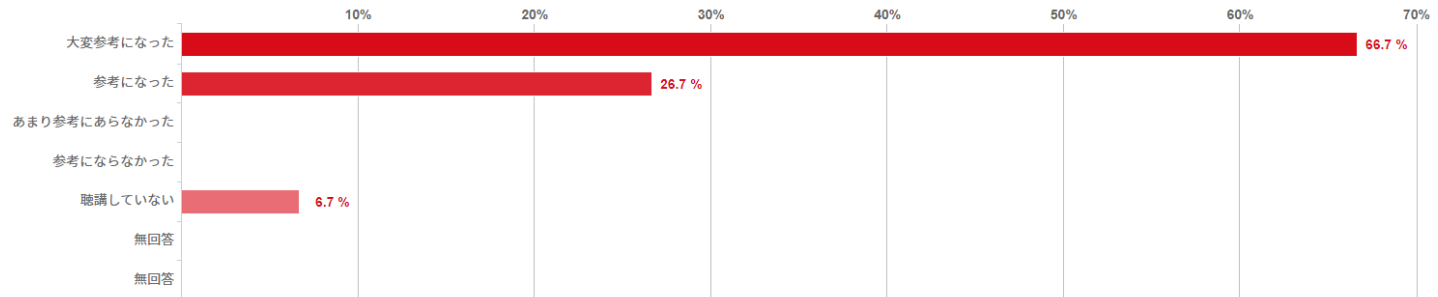
# アンケート内容

## Q8.

フロントローディングの領域拡張について（1つお選びください）

（回答数: 30）

参考になったとの意見が多い。

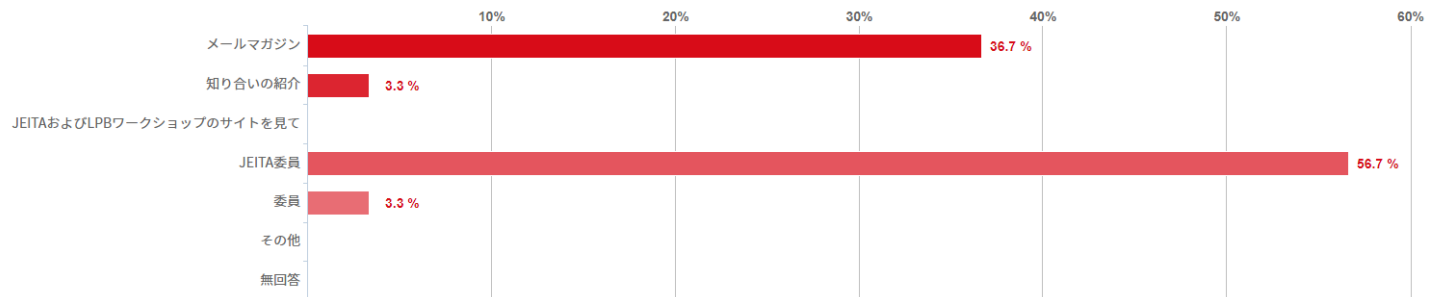


## Q9.

本フォーラムはどこで知りましたか？（1つお選びください）

（回答数: 30）

JEITA委員の割合が多かったが、メルマガの割合が22%→37%へ増加。



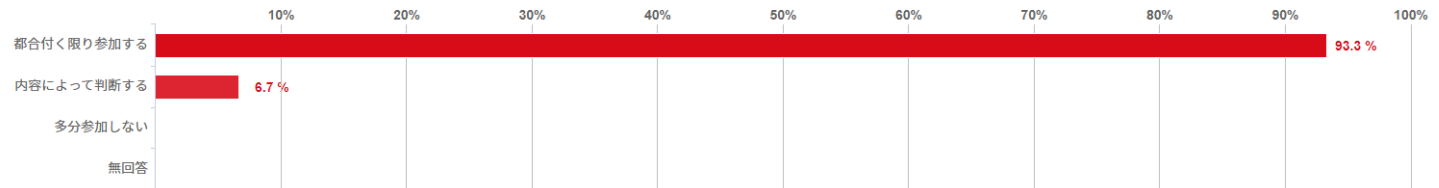
# アンケート内容

## Q10.

次回も参加したいですか？(1つお選びください)

(回答数: 30)

継続参加を希望する意見が多い。



# アンケート内容

Q11.LPBフォーラムでディスカッションしたい内容はありますか？ご自由にお書きください

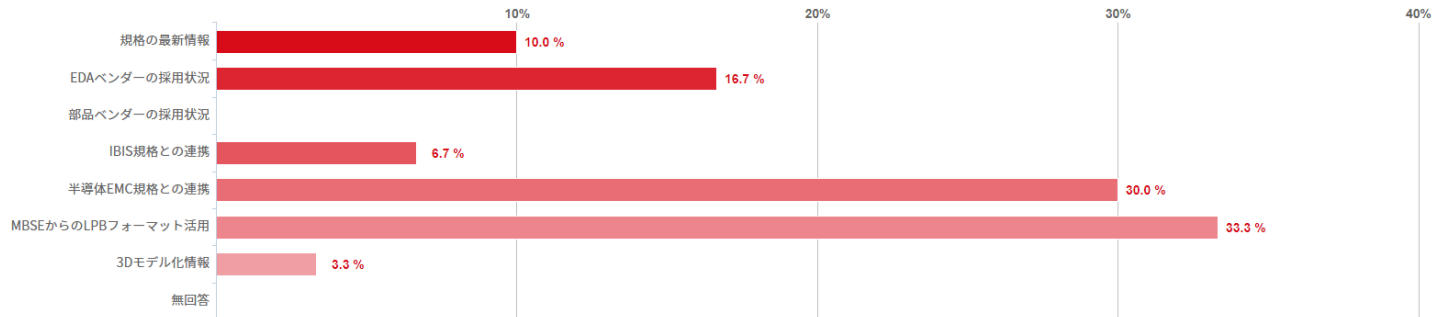
- ・半導体とか通信とかは個別学会がありますが機器レベルのカンファレンスはあまりないので機器学会ほくペーパーとか募集したいですね
- ・モデル流通で利益をだせるか？

# アンケート内容

## Q12.

次回を取り上げて欲しいですか？(LPBフォーマットに関して1つお選びください)  
(回答数: 30)

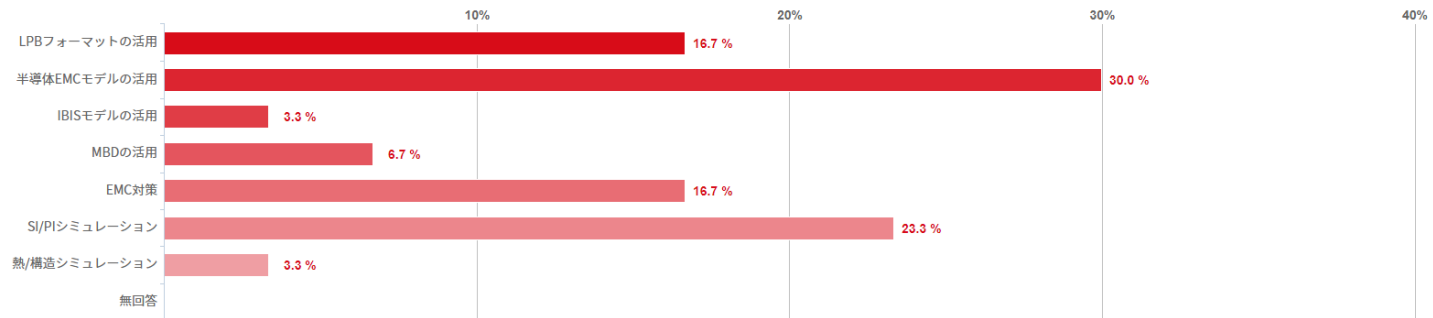
前回同様に「MBSEからのLPBフォーマット活用」について希望する意見が多かった。



## Q13.

次回を取り上げて欲しいですか？(活用事例に関して1つお選びください)  
(回答数: 30)

従来は「LPBフォーマットの活用事例」を希望する意見が多かったが、今回は「半導体EMCモデルの活用」が大幅に増加(11%→30%)している。

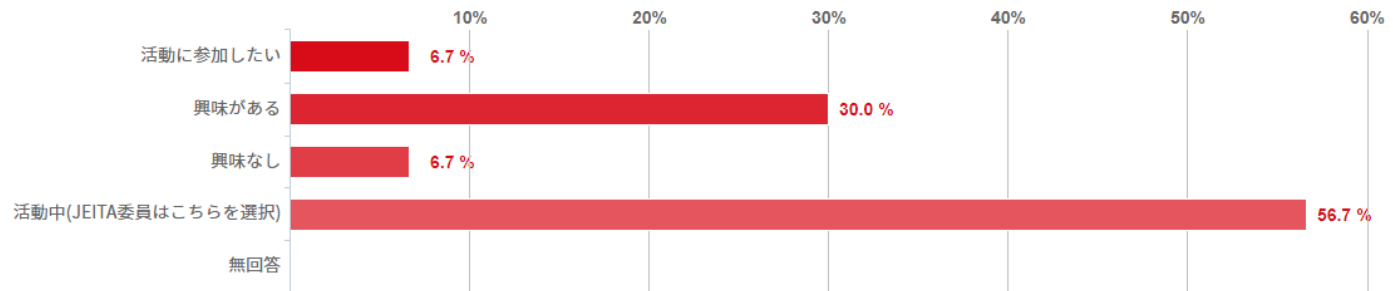


# アンケート内容

## Q14.

半導体&システム開発技術SCの活動に興味がありますか？(1つお選びください)

(回答数: 30)





# アンケート内容

Q15.本活動に期待する事、本フォーラムで興味あった内容、もっと詳しく知りたい内容などご自由にお書きください

・アンケートで複数回答できる所を設けて欲しい

・DCDCコンバータのEMC解析

・デバイスモデルDXと共催にしたらどうか

・MBSEの活用が広がっているのは素晴らしいと思います。林様のご発表の中では設計フロー検討の手段としての活用に触れられていました。この活用が、個々の開発案件ごとにMBSEを活用する、という展開はあり得るでしょうか?もしそうならば、MBSEのモデルデータの中でLPBフォーマットや他のEDAデータへのリンクを張るなどの形で、LPBフォーマットの活用とつながるかもしれませんね。

# アンケート内容

リアル開催の良さを感じたという意見が多いが、Webは参加し易いとの意見も多く、全体的にハイブリッド開催は支持されている。

## Q16.Webでの開催についてご意見があればお願いします

- ・やはりリアルが良いと感じました。
- ・FtoFは有意義でした
- ・ハイブリッドだと参加し易い。
- ・Hybridがよいと思います。
- ・リアル会場の音声をweb参加者にどう共有するのは課題だと思う。
- ・議論を多くしたいのでF2Fやパネル形式などにしたい
- ・会場の声が聞こえにくい時があった。
- ・できるだけF2Fが良いと思います。
- ・次回もWEB開催をよろしく願いいたします。
- ・Web開催は廃止し、リアル開催に戻す、で良い。
- ・都合がつかず短時間の聴講となりましたが、Web開催は非常にありがたいです。